

DBO309/OBO309

雷神科技公司美元計價外國債券

Tender Offers 現金收購要約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 DBO309/OBO309 雷神科技公司美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US913017BT50)，本行於 2020 年 9 月 30 日接獲保管機構 Clearstream 通知，第三方公司 Applied Alpha LP 宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，謹將該債券收購要約(Tender Offer，以下簡稱“收購要約”)內容摘要如下：

1. 針對雷神科技公司西元 2028~2048 年到期之 3 檔系列債券，第三方公司 Applied Alpha LP 宣布向債券投資人公開收購，債券投資人所持有之 DBO309/OBO309 雷神科技公司美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US913017BT50) 債券亦列於本次收購要約之中，本次收購金額上限為 4.15 億美元。

2. 早鳥收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2020/10/6 下午 3 時 30 分前(以本行收到債券收購要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券收購之要約參與意願書，可按該公司提供之收購要約，以 2050/5/15 到期，票面利率 1.25% 美國公債到期殖利率加 167bps 為折現率計算出現金流量折現值作為早鳥收購價格，該收購價格之定價時間為 2020/10/8 紐約時間下午 12:00，另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。債券投資人可以自由選擇是否參與，惟不保證債券收購成功。參與收購最小面額為 10,000 美元，增額 1,000 美元，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

Security Description	CUSIP No. and ISIN No.	Outstanding Principal Amount	Acceptance Priority Level	Early Participation Payment ⁽¹⁾	Benchmark Security	Bloomberg Reference Page	Tender Spread
4.500% Senior Notes due 2042	913017BT5 / US913017BT50	U.S.\$3,500,000,000	1	U.S.\$50	1.250% U.S. Treasury Note due 15 May 2050	FIT	+167 bps
4.625% Senior Notes due 2048	913017CX5 / US913017CX53	U.S.\$1,750,000,000	2	U.S.\$50	1.250% U.S. Treasury Note due 15 May 2050	FIT	+172 bps
4.125% Senior Notes due 2028	913017CY3 / US913017CY37	U.S.\$3,000,000,000	3	U.S.\$50	0.625% U.S. Treasury Note due 15 Aug 2030	FIT	+146 bps

3. 一般收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2020/10/22 下午 3 時 30 分前(以本行收到債券收購要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券收購之要約參與意願書，可按該公司提供之收購計畫，以 2050/5/15 到期，票面利率 1.25% 美國公債到期殖利率加 167bps 為折現率計算出現金流量折現值再扣除 5% 作為一般收購價格(即為早鳥收購價扣除 5%)，另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。債券投資人可以自由選擇是否參與，惟不保證債券收購成功。參與收購最小面額為 10,000 美元，增額 1,000 美元，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

4. 所信託投資之 DBO309/OBO309 雷神科技公司美元計價外國債券 發行機構收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

ISIN Code	到期日	發行機構 收購價	2020 年 9 月 30 日 次級市場 參考贖回價(不含前手息)
US913017BT50	2042/6/1	未定	125.25%

5. 本債券收購要約悉依 Applied Alpha LP 公布之內容條款辦理，英文版收購要約可參考下列公告內容，即日起至截止日(早鳥計畫為 2020/10/6 下午 3 時 30 分，一般計畫為 2020/10/22 下午 3 時 30 分)止，本行受理申請參與債券收購，債券投資人如欲參與收購請填妥參與意願書，並回覆至本行各分行辦理相關事宜，未於截止日前回覆，則視為債券投資人選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Tender Offers」收購計畫。



6. 倘債券投資人所信託投資之債券於本次債券收購要約中未獲收購，或債券投資人選擇不參與本次債券收購要約，債券投資人仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若部分參與收購，造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。
7. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與債券收購與否，債券投資人所提出之「參與意願書」亦不保證成功參與債券收購。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。
8. 本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如對於此債券收購要約計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

星展(台灣)商業銀行股份有限公司 謹

DBO309/OBO309

雷神科技公司美元計價外國債券
Tender Offers 現金收購要約參與意願書

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____，信託帳號：_____)

知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券收購要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表收購成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與債券收購要約
2. 同意參與債券早鳥收購要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為台灣時間 2020/10/6 下午 3 時 30 分前)

欲參與收購之債券面額：

3. 同意參與債券一般收購要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為台灣時間 2020/10/22 下午 3 時 30 分前)

欲參與收購之債券面額：

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：_____ (請加蓋原留印鑑)

- * 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑
- * 若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

日期：民國_____年_____月_____日

銀行專用		
客戶經理：	核章：	主管：

受理日期與時間：_____